

技術資料表

FeedBond® FP-6100-HP9

低溫全燒結固晶銀漿

說明：

FeedBond® FP-6100-HP9 是奈米級全燒結固晶銀漿，可用在需要高導電與高導熱的半導體封裝設計。為了獲得最佳性能，所使用的晶片和基板必須鍍金或鍍銀。不具樹脂成分，以純金屬接著，顯著提升產品的導熱性。

應用：

- 高功率的封裝產品。
- 在高溫環境工作的封裝產品。
- SIP/QFN/LGA/HBLED

特點：

- 極佳的高溫推力；極佳的導電能力。
- 適合用在沾膠與點膠製程
- 極佳的導熱能力。
- 可低溫燒結 (180-200°C)。

規格項目	量測結果	量測方法	量測依據
外觀	銀色膏狀	目視	-
金屬合金	銀粉	-	-
銀粉含量	>95%	TGA	FT-P010
黏度 @ 25°C	8,000~12,000 cPs	Brookfield CP-51 @5rpm	FT-P006
搖變指數	5.5 ~ 7.5	Brookfield CP-51 Vis. @ 0.5rpm/5rpm	FT-P008
比重	6.3 g/cm ³	比重瓶/天平	FT-P001
燒結方式* < 2x2mm	1. 20 分鐘升至 110°C 並維持 30-60 分鐘； 30 分鐘升至 200°C 並維持 90 分鐘。 2. 20 分鐘升至 110°C 並維持 30-60 分鐘； 30 分鐘升至 180°C 並維持 120 分鐘。	烘箱	-
燒結方式* > 2x2mm	1. 20 分鐘升至 110°C 並維持 60-90 分鐘； 30 分鐘升至 200°C 並維持 120 分鐘。 2. 20 分鐘升至 110°C 並維持 60-90 分鐘； 30 分鐘升至 180°C 並維持 150 分鐘。		
熱導率	140 W/mK	Hot Disk	FT-P022
體積電阻	6*10 ⁻⁶ Ohm-cm	-	FT-P017
DSS @260°C	>2 Kg-f*	1mm*1mm On Ag	-
作業時間@ 25°C	16hr	黏度提高 50% @ 5rpm	FT-P024
保存期限@ -40°C	6 months	-40°C	FT-P018

*上述燒結方式為指導性建議。燒結條件（時間和溫度）可能會根據客戶的經驗和應用要求有所不同。客戶可根據燒結設備、烘箱負載和實際烘箱溫度自行調整。

用法說明：

● 解凍：

解凍時，請將針筒（瓶、罐）直立解凍，直到完全達室溫時才能使用（回溫時間 30~90 鐘），請擦乾解凍時凝結在包裝外的水氣；不可反覆解凍及冷凍以防止異常分離現象及氣泡等之產生。

● 儲存：

當您收到貨品時，請立即以低溫（-20°C或-40°C）儲存。由於不同溫度下之保存將影響產品的壽命。

儲存溫度	-35°C~-42°C	-18°C~-22°C	0°C~5°C	18°C~28°C
保存期限	6 個月	3 個月	1 個月	2 天

● 運輸

運送過程皆放入乾冰或低溫冰袋等低溫保存並放置溫度指示劑以確保產品品質。當您收到貨品時發現已無乾冰殘留（或溫度指示劑呈現液態），請立即拍照存證勿使用，並立刻通知我司營業人員。

可取得方式：

FeedBond 低溫半燒結銀漿根據客戶要求包裝在針筒或罐子中。有關詳細信息，請聯繫我們的客戶服務或銷售部門。

P.S. 這些資訊是根據我們目前在這個產品上的知識，僅適用於貴司在實驗室的實驗產品；所以，請盡量進行詳細完整的測試，以確認此材料在特定的目的上是否適合貴司需求。隨著產品性能提升，此文件可能會進行修訂。由於我們無法預期實際上最終使用條件與所有變因，因此肥特補不對任何使用此文件的產品做出保證，也不承擔任何責任。本文件中的任何內容均不得被視為根據或任何專利進行操作的許可或建議。